

**This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- **BLACK BORDERS**
- **TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- **FADED TEXT**
- **ILLEGIBLE TEXT**
- **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- **COLORED PHOTOS**
- **BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS**
- **GRAY SCALE DOCUMENTS**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(51) Int. Cl.²: **E 04F 15/10**

(19) Federal Republic of Germany
German Patent Office

(11) **PATENT LAID OPEN FOR INSPECTION**

25 08 628

(21) Ref. No.: P 25 08 628.6-25

(22) Application Date: February 27, 1975

(43) Disclosure Date: September 9, 1976

(30) Union Priority: (32) (33) (31)

RECEIVED
TECHNOLOGY CENTER 3600
02 FEB 20 PM 12: 56

RECEIVED
FEB 21 2002
GROUP 3600

(54) Designation: Floor Element

(71) Applicant: Mang, Josef, 8941 Holzgrün

(72) Inventor: Same as Applicant

An application for examination, pursuant to § 28 b of the Patent Act, has been filed.

DT 25 08 628 A 1

All Languages Ltd

2508628

Hubert Freiherr von Welser, Solicitor
Admitted to District Courts I and II of Munich,
The Appeal Court of Munich and to the Supreme
Land Court of Bavaria

8000 Munich 40
Danziger Straße 15
Tel.: *[illegible]*

February 27, 1975

DESCRIPTION OF THE INVENTION

FLOOR ELEMENT

Applicant:
Josef Mang
8941 Holzgünz
via Memmingen

RECEIVED
TECHNOLOGY CENTER 3600
02 FEB 20 PM 12: 56

The invention relates to a floor element comprised of a wood-chip board to the underside of which a one-piece board, made of expanded plastic, has been glued.

RECEIVED
FEB 21 2002
GROUP 3600

[stamp]: Original inspected

609837/0125

Banking: Deutsche Bank AG Munich (Banking Code 700 700 10)
Postal Cheque Account: Munich 1999 94-803
[illegible next line]

All Languages Ltd

Such a floor element can be positioned between the floor and the floor covering, where it is placed on the floor structure, for example made of concrete, either directly, or nailed to wood bearings, or suspended over loose fill. Thus, it replaces a floor finish, for example asphalt, applied to the floor structure. Placing the layer of plastic on the underside of the wood-chip board serves the purpose of thermal insulation and sound absorption in particular footfall sound attenuation. It is preferable to use rigid thermoplastic boards made of Styropor®. The wood-chip boards are comprised of fine wood chips or fibres bonded with synthetic resin wherein the plastic bond is kept so lean that the wood chips can very easily absorb water from the environment either in liquid form or as a vapor, and conduct it further in themselves.

As a result of this characteristic of the wood-chip board, the bottom layer of the wood-chip board absorbs more water than the top layer when moisture penetrates the underside of the wood-chip board, which means when it originates from the floor structure due to, for example, moisture equalization between the room situated above and below. As a consequence of expansion of the wood fibres in the bottom layer, due to moisture, cupping occurs in the wood-chip board. The same effect occurs if the moisture is withdrawn too quickly from the surface, especially if the upper surface dries faster than the moisture supplied from below. On the other hand reversed warping, namely, bulging, can occur due to a greater supply of moisture from the top side. The layer of expanded plastic does not form an adequate moisture barrier in this respect. On the contrary, the layer is penetrated by water in the vapor phase. If in the room below the floor structure and, therefore, also in the latter, the vapor pressure is higher than in the room above, moisture will penetrate the wood-chip board from below. Due to the drying on the upper side, the board is subjected to a non-uniform moisture attack and cupping occurs. On the other hand, the vapor pressure can undo

the bonding between the wood-chip board and the plastic board, thus creating gaps in which water of condensation can accumulate.

The task of the invention is to prevent these disadvantages, especially the warping of the wood-chip board due to the non-uniform absorption of moisture.

This problem is solved, according to the invention, by providing parallel, groove-shaped recesses at the upper and lower bearing surface of the plastic board and by allowing the webs that are narrower than the recesses to remain and, furthermore, by staggering the recesses of one bearing surface in relation to the recesses of the other bearing surface in such a way that one web of one bearing surface, respectively, is facing the center of the recess of the other bearing surface. The groove-shaped recesses can be either rectangular, trapezoidal or rounded in cross-section. The recesses are preferably 20 mm wide and 5 mm deep.

The plastic board is bonded to the wood-chip board by the surface of the webs of the upper bearing surface of the plastic board. The bonding is carried out in point form at 2 to 3 cm intervals in order to prevent the wood-chip board from becoming warped due to the moisture absorbed from the glue.

With the bearing surface of the webs positioned on the bottom bearing surface of the plastic board, the latter rests on floor bearings, or is suspended over fill, or if the fill is sufficiently even, the plastic board rests directly on the floor structure.

The groove-shaped recesses on the bottom bearing surface of the plastic board together with the contact surface form channels into which the water vapor, rising in the floor structure, can escape and by means of which the vapor can be carried off up to the wall. At the wall the water vapor is either absorbed by the

plaster and the brickwork, or it is conducted further to the space above the floor via the gap to be left open between the joint of the floor element and the wall. Thus, the water vapor rising from the bottom is guided around the moisture-sensitive chipboard layer. The required movement of the vapor within the channels, formed by the recesses, is generated by the pressure of the vapor itself that escapes there from the bottom.

The water, which urges from the bottom upward during the vapor and liquid phase, can henceforth pass into the interior of the plastic board at narrow contact surfaces of the bottom webs. However, the rising moisture cannot reach the bottom of the wood-chip board, since its direct path leads to the channels, formed by the groove-shaped recesses of the upper bearing surface of the plastic board, where the water vapor escaping there is carried off towards the wall. The path up to the webs of the upper bearing surface of the plastic board and the latter's contact surface at the wood-chip board, leads along the surface area and along the side walls of the groove-shaped recesses, i.e. it leads along a considerably extended course, whereby the moisture in the form of vapor is given off in the above-mentioned channel. In order to extend this course as far as possible and to prevent - up to the wood-chip board - a path of direct moisture-seepage from flowing vertically to the ground surface, the groove-shaped recesses are of a wider construction than the webs.

Water of condensation resulting from differences or fluctuations in temperature, can only accumulate at the base of the channels where it will evaporate. It will then be carried off as water vapor in the direction of the walls. A cracking of the bond between the wood-chip board and the plastic board is prevented by the invented arrangement, according to which first of all no moisture worth mentioning can reach such bonding and, secondly, the water of condensation that forms must accumulate in the recesses of the plastic board.

The arrangement of the webs and recesses is also advantageous with respect to sound absorption since here too the path of sound conducted through solids is extended by staggering the recesses and webs and by the greater width of the recesses. Furthermore, the above-mentioned arrangement ensures a greater elasticity of the board, reduces the inherent rigidity and, therefore, the resonance effect of the plastic board.

Although the described design of the plastic board makes it possible to prevent moisture from rising upward from the bottom and passing into the wood-chip board by way of direct contact, it cannot prevent the wood-chip board from absorbing water from the general atmospheric moisture that prevails. If the moisture content of the air is greater here than in the room above the wood-chip board, the bottom layers of the wood-chip board can be attacked extensively by moisture whereas its upper layers can dry quickly. This results in cupping for example, if the temperature in the room above is higher. To prevent this, a familiar vapor-braking layer is applied, according to the invention, to the top side of the wood-chip board. This can be accomplished by impregnating with a vapor-braking liquid medium. It will prevent the moisture, absorbed from below by the wood-chip board, from evaporating quickly whilst rising upward. It will also prevent a non-uniform distribution of moisture via the cross-section of the wood-chip board. Thus, a variable expansion in the individual layers of the board due to moisture will not occur and the board can expand uniformly in any depth of layer without becoming warped. Furthermore, the vapor-braking layer also prevents a non-uniform expansion even if the moisture supply from the upper surface of the wood-chip board is larger than the supply of moisture rising from below.

An embodiment of the invention is described below in greater detail based on the drawing which shows

a vertical cross-sectional view of the floor element, according to the invention, and the floor structure underneath it.

The illustrated floor element has on its upper side a 22-mm thick wood-chip board (1). This board is tongue-and-groove butt jointed to the wood-chip boards of other interlocked elements of the same kind. On its upper side the wood-chip board (1) can be provided with any floor covering which, for example, can be glued on. At its bottom side the wood-chip board has been provided with a plastic board (2) that has grooved-shaped recesses (3, 4) on its top side and on its underside. These recesses allow webs (5, 6) to remain on the top side and on the underside. The cross-sectional dimensions of the webs are narrower than those of the recesses. In the illustrated example the ratio is 14:17mm. The recesses run parallel to one another on each side and also parallel to the recesses of the respective opposite side. The plastic board (2) is made of foamed plastic, for example Styropor[®] with a compressed cell structure in order to achieve more effective sound absorption. At the bearing surfaces of the webs (5) the plastic board (2) is bonded to the wood-chip board (1) in point form, which means that the webs have in their longitudinal direction a series of bonding points at approximately 3 cm intervals. The plastic board (2) rests with the bearing surfaces of the webs (6) directly on the concrete floor (7) to which the floor element can be dowel-jointed. A layer (8) of a vapor-braking medium has been applied to the upper surface of the wood-chip board.

Patent Claims

1. A floor element, comprised of a wood-chip board to the underside of which a continuous board of foamed plastic is bonded, is **characterized** by the fact that at the top and bottom bearing surface of the foamed plastic board (2) parallel, groove-shaped recesses (3, 4) of the same width have been provided that allow webs (5, 6), which are narrower than the recesses, to remain among them and that the recesses (3,4) of one bearing surface of the foamed plastic board (2) are staggered in relation to the recesses of the other bearing surface in such a way that one web (5,6) of one bearing surface, respectively, is facing the centre of a recess of the other bearing surface.
2. A floor element, as set forth in Claim 1, wherein the groove-shaped recesses (3, 4) are rectangular, trapezoidal or rounded in cross-section.
3. A floor element, according to Claims 1 and 2, wherein the recesses are 20 mm wide and 5 mm deep.
4. A floor element, according to Claims 1, 2 and 3, wherein the foamed plastic board (2) is bonded in point form to the wood-chip board (1) at the bearing surface of the webs (5).
5. A floor element, according to Claims 1, 2, 3 and 4, wherein a layer (8) of a vapor-braking medium has been applied to the upper surface of the wood-chip board (1).

2508628

8

[1 blank page]

[1 page of drawings]:

Subsequently submitted

2508628

Eu4F 15-1U

At: 27.02.1975

OT:09.09.1976

609837/0125

A F F I D A V I T

I, Helga Gallé, translator for ALL LANGUAGES LTD. of Toronto, in the Province of Ontario, make oath and say:

1. I understand both the German and the English languages;
2. I have carefully compared the annexed translation from German into English with Patent No. 25 08 628 of the German Patent and Trademark Office.
3. The said translation, done by me, is, to the best of my knowledge and ability, a true and correct translation of the said documents in every respect.

SWORN before me in the City of
Toronto, this 15th day of
January A.D. 2002

A Notary Public in and for the
Province of Ontario.

**MAURICE PENZO, Notary Public, City
of Toronto, limited to the attestation of
Instruments and the taking of affidavits,
for All Languages Ltd.**
Expires December 12, 2004.

All Languages Ltd

2508628

HUBERT FREIHERR VON WELSER
RECHTSANWALT

ZUGELASSEN AN DEN LANDGERICHTEN MÜNCHEN I UND II,
AM OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN UND AM
BAYERISCHEN OBERSTEN LANDESGERICHT

8000 MÜNCHEN 40
DANZIGER STRASSE 16
TELEFON 699/5 01 99 90

27. Februar 1975

Beschreibung der Erfindung

Fußbodenelement

Anmelder:

Josef Mang
8941 Holzgünz
über Memmingen

Die Erfindung betrifft ein Fußbodenelement, bestehend aus einer Holzspanplatte, auf deren Unterseite eine durchgehende Platte aus verschäumtem Kunststoff aufgeleimt ist.

ORIGINAL INSPECTED

609837/0125

BANKKONTO: DEUTSCHE BANK AG MÜNCHEN 22/25 643 (BLZ 700 700 10) - POSTSPARBUCHKONTO: MÜNCHEN 1888 84-803

Received Time DEUTSCHE Feb. 8. 3:48PM Print Time Feb. 8. 3:56PM

Ein solches Fußbodenelement kann zwischen Decke und Bodenbelag angeordnet sein, wobei es auf der Deckenkonstruktion, z.B. aus Beton, unmittelbar oder auf Holzlagern aufgenagelt oder auf loser Schüttung schwimmend verlegt ist. Es ersetzt dann einen auf der Deckenkonstruktion aufgetragenen Estrich z.B. aus Asphalt. Das Anordnen der Schicht aus verschäumtem Kunststoff auf der Unterseite der Holzspanplatte dient der Wärmedämmung und der Schalldämpfung, insbesondere der des Trittschalles. Vorzugsweise werden Hartschaumplatten aus Styropor verwendet. Die Holzspanplatten bestehen aus mit Kunstharz verleimten feinen Holzspänen oder -Fasern, wobei die Kunststoffbindung so mager gehalten ist, daß die Holzfasern sehr leicht aus der Umgebung Wasser, sei es flüssig oder dampfförmig, aufnehmen und in sich weiterleiten können.

Diese Eigenschaft der Holzspanplatten hat zur Folge, daß bei Eindringen von Feuchtigkeit von ihrer Unterseite, also von der Deckenkonstruktion her, z.B. in Folge von Feuchtigkeitsausgleich zwischen dem darunterliegenden und dem darüberliegenden Raum, die untere Schicht der Holzspanplatte mehr Wasser aufnimmt als die obere. Wegen der Feuchtigkeitsdehnung der Holzfasern in der unteren Schicht tritt eine schüsselförmige Verwölbung der Holzspanplatte ein. Der

609837/0125

gleiche Effekt ergibt sich auch durch zu raschen Feuchtigkeitsentzug von der Oberfläche her, insbesondere dann, wenn die Austrocknung der oberen Oberfläche rascher erfolgt, als der Feuchtigkeitsnachschub von unten. Andererseits kann durch größeres Feuchtigkeitsangebot von der Oberseite her eine umgekehrte, sich ausbauchende Verwölbung eintreten. Die Schaumstoffschicht bildet dabei keine ausreichende Feuchtigkeitsperre. Vielmehr wird sie von Wasser in der Dampfphase durchsetzt. Herrscht also in dem unter der Deckenkonstruktion liegenden Raum und daher auch in dieser ein höherer Dampfdruck als im darüberliegenden Raum, so dringt Feuchtigkeit von unten in die Holzspanplatte ein. Infolge der Austrocknung an der Oberseite entsteht eine ungleichförmige Feuchtigkeitsbeaufschlagung der Platte, so daß sie sich schüsselförmig verwirft. Der Dampfdruck kann andererseits die Verleimung zwischen Holzspanplatte und Schaumstoffplatte lösen, so daß Spalträume entstehen, in denen sich Kondenzwasser ansammeln kann.

Aufgabe der Erfindung ist es, diese Nachteile zu vermeiden, insbesondere das sich Verwerfen der Holzspanplatte infolge ungleichmäßiger Feuchtigkeitsaufnahme zu verhindern.

609837/0125

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß an der oberen und der unteren Lagerfläche der Schaumstoffplatte parallele nutförmige Ausnehmungen vorgesehen sind, die Stege stehen lassen, die schmaler sind als sie, und daß die Ausnehmungen der einen Lagerfläche gegenüber den Ausnehmungen der anderen Lagerfläche derart versetzt sind, daß jeweils ein Steg der einen Lagerfläche der Mitte einer Ausnehmung einer anderen Lagerfläche gegenüberliegt. Die nutförmige Ausnehmungen können einen rechtwinkligen oder trapezförmigen Querschnitt aufweisen oder einen solchen mit abgerundeten Ecken. Die Breite der Ausnehmungen beträgt vorzugsweise 20 mm, ihre Tiefe 5 mm.

Mit der lagerseitigen Oberfläche der Stege der oberen Lagerfläche der Schaumstoffplatte wird diese mit der Holzspanplatte verleimt. Die Verleimung erfolgt zweckmäßigerweise punktförmig in Abständen von 2 bis 3 cm, um ein sich Verwerfen der Holzspanplatte in Folge der aus dem Leim aufgenommenen Feuchtigkeit zu vermeiden.

Mit der Auflagefläche der Stege auf der unteren Lagerfläche der Schaumstoffplatte liegt diese auf Bodenlagern, schwimmend auf einer Schüttung oder, falls diese genügend eben ist, auf der Bodenkonstruktion unmittelbar auf.

609837/0125

Die nutzförmigen Ausnehmungen auf der unteren Lagerfläche der Schaumstoffplatte bilden dann zusammen mit der Auflagefläche Kanäle, in die der in der Deckenkonstruktion aufsteigende Wasserdampf austreten und über die er bis zur Wand abgeführt werden kann. Dort wird er von dem Putz und dem Steinwerk aufgenommen oder über den zwischen dem Stoß des Fußbodenelements und der Wand frei zu lassenden Spalt in den Raum oberhalb des Bodens weitergeleitet. Der von unten aufsteigende Wasserdampf wird also um die feuchtigkeitsempfindliche Holzspanplattenschicht herumgeleitet. Die erforderliche Bewegung des Dampfes innerhalb der von den Ausnehmungen gebildeten Kanälen wird durch den Druck des dort von unten austretenden Dampfes selbst erzeugt.

Ein Übertritt des in der Dampf- oder Flüssigphase von unten aufdringenden Wassers in das Innere der Schaumstoffplatte ist nurmehr an den schmalen Auflageflächen der unterseitigen Stege möglich. Die Feuchtigkeit kann aber im weiteren Aufsteigen die Unterseite der Holzspanplatte nicht erreichen, da ihr unmittelbarer Weg in die von den nutzförmigen Ausnehmungen der oberen Lagerfläche der Schaumstoffplatte gebildete Kanäle führt, wo ein Abtransport eines dort austretenden Wasserdampfes nach der Wand zu erfolgt. Der Weg bis zu den Stegen der oberen

609837/0125

Lagerfläche der Schaumstoffplatte und deren Anlagefläche an der Holzspanplatte führt an der Grundfläche und an den Seitenwänden der nutzförmigen Ausnehmung entlang, also über einen erheblich verlängerten Weg, wobei die Feuchtigkeit als Dampf in den genannten Kanal abgegeben wird. Um diesen Weg so weit wie möglich zu verlängern und um senkrecht zur Bodenfläche verlaufende direkte Sickerwege der Feuchtigkeit bis zur Holzspanplatte zu vermeiden, sind die nutzförmigen Ausnehmungen jeweils breiter gehalten als die Stege.

Bei Temperaturdifferenzen oder -Schwankungen anfallen- das Kondenzwasser kann sich nur auf dem Grund der Kanäle sammeln und dort wieder verdunsten. Es wird dann wieder als Dampf in Richtung nach den Wänden abgeführt. Ein Aufspalten der Verleimung zwischen Holzspanplatte und Schaumstoffplatte ist durch die erfindungsgemäße Anordnung dadurch vermieden, daß einmal keine nennenswerte Feuchtigkeit mehr bis zu dieser Verleimung gelangen kann und andererseits das sich bildende Kondenzwasser sich in den Ausnehmungen der Kunststoffplatte sammeln muß.

Die Anordnung der Stege und Ausnehmungen wirkt sich desweiteren günstig für die Schalldämpfung aus, da auch hier durch die Versetzung der Ausnehmungen und

609837/0125

Stege gegeneinander und durch die größere Breite der Ausnehmungen der Leitweg für den Körperschall verlängert wird. Außerdem wird durch die genannte Anordnung die Elastizität der Platte erhöht und deren an sich gegebene Starrheit und damit die Resonanzwirkung der Schaumstoffplatte herabgesetzt.

Durch die beschriebene Ausgestaltung der Schaumstoffplatte kann zwar der durch unmittelbaren Kontakt erfolgende Feuchtigkeitsübergang von unten auf die Holzspanplatte unterbunden werden, nicht aber deren Wasseraufnahme aus der allgemeinen Luftfeuchtigkeit, die unter ihr herrscht. Wenn hier ein größerer Feuchtigkeitsgehalt der Luft als in dem Raum oberhalb der Holzspanplatte vorhanden ist, kann eine so weitgehende Feuchtigkeitsbeaufschlagung der Holzspanplatte in ihren unteren Schichten, dagegen aber eine rasche Austrocknung in ihren oberen Schichten erfolgen, daß der Effekt der schüsselförmigen Verwerfung eintreten muß, z.B. dann, wenn im darüberliegenden Raum eine höhere Temperatur herrscht. Um dies zu verhindern, ist gemäß der Erfindung eine an sich bekannte dampfbremssende Schicht auf der Oberseite der Holzspanplatte aufgebracht. Dies kann zweckmäßigerweise durch Imprägnieren mit einem dampfbremssenden Mittel in flüssiger Form geschehen. Damit wird verhindert, daß die von der Holzspanplatte von unten aufgenommene Feuchtigkeit nach oben zu rasch verdunstet und sich über den Querschnitt der Holzspanplatte eine ungleichmäßige Feuchtig-

609837/0125

keitsverteilung ergibt. Demnach unterbleibt eine unterschiedliche Feuchtigkeitsdehnung in den einzelnen Plattenschichten und die Platte kann sich vielmehr in allen Schichttiefen gleichmäßig und ohne Verwerfen dehnen. Andererseits verhindert diese dampfbremsende Schicht auch dann eine ungleichmäßige Dehnung, falls das Feuchtigkeitsangebot von der oberen Oberfläche der Holzspanplatte größer ist, als das der von unten aufsteigenden Feuchtigkeit.

Ein Beispiel der Erfindung ist im Folgenden näher beschrieben und ist in der Zeichnung dargestellt. Diese zeigt

einen vertikalen Schnitt durch erfindungsgemäßes Fußbodenelement und die darunterliegende Deckenkonstruktion.

Das dargestellte Fußbodenelement weist an seiner Oberseite eine Holzspanplatte 1 mit einer Dicke von 22 mm auf. Diese ist mit den Holzspanplatten weiterer gleichartiger im Verband verlegter Elemente an den Stoßfugen nut- und federartig verzahnt. Auf der Oberseite der Holzspanplatte 1 kann sie mit einem beliebigen Bodenbelag, z.B. durch Aufkleben versehen werden. Auf der Unterseite der Holzspanplatte ist eine Schaumstoffplatte 2 vorgesehen,

ORIGINAL DISCLOSED

603837/0125

die nutzförmige Ausnehmungen 3 an ihrer Oberseite und 4 an ihrer Unterseite aufweist. Diese Ausnehmungen lassen Stege 5 an der Oberseite und 6 an der Unterseite stehen, deren Querabmessung schmaler ist als die der Ausnehmungen. Im dargestellten Beispiel ist das Verhältnis 14 zu 17 mm. Die Ausnehmungen verlaufen auf jeder Seite unter sich parallel und ebenso parallel zu den Ausnehmungen der jeweiligen Gegenseite. Die Schaumstoffplatte 2 besteht aus verschäumtem Kunststoff, z. B. Styropor mit zusammengesetzter Zellenstruktur, um eine größere Schalldämpfung zu erzielen. An den Auflageflächen der Stege 5 ist die Schaumstoffplatte 2 mit der Holzspanplatte 1 punktförmig verleimt, das heißt, den Stegen folgt in ihrer Längsrichtung eine Reihe von Verleimpunkten, die in einem Abstand von etwa 3 cm auseinanderliegen. Die Schaumstoffplatte 2 liegt mit den Auflageflächen der Stege 6 unmittelbar auf der Betondecke 7 auf, mit der ^{das Fußbodenelement} / verdübelt verbunden sein kann. Auf der oberen Oberfläche der Holzspanplatte ist eine Schicht 8 eines dampfbremsenden Mittels eingelassen.

Patentansprüche

609837/0125

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Fußbodenelement, bestehend aus einer Holzspanplatte, auf deren Unterseite eine durchgehende Platte aus verschäumtem Kunststoff aufgeleimt ist, dadurch gekennzeichnet, daß an der oberen und der unteren Lagerfläche der Schaumstoffplatte (2) parallele gleich breite nutförmige Ausnehmungen (3,4) vorgesehen sind, die Stege (5,6) zwischen sich stehen lassen, die schmaler sind als sie, und daß die Ausnehmungen (3,4) der einen Lagerfläche der Schaumstoffplatte (2) gegenüber den Ausnehmungen der anderen Lagerfläche derart versetzt sind, daß jeweils ein Steg (5,6) der einen Lagerfläche der Mitte einer Ausnehmung der anderen Lagerfläche gegenüberliegt.
2. Fußbodenelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die nutförmigen Ausnehmungen (3,4) einen rechtwinkligen, trapezförmigen Querschnitt oder einen solchen mit abgerundeten Ecken aufweisen.
3. Fußbodenelement nach Anspruch 1,2, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite der Ausnehmungen 20 mm und ihre Tiefe 5 mm beträgt.

609837/0125

4. Fußbodenelement nach Anspruch 1,2,3,
dadurch gekennzeichnet, daß die Schaumstoffplatte
(2) mit der Holzspanplatte (1) an der Auflagefläche
der Stege (5) der Schaumstoffplatte (2) punktförmig
verleimt ist.
5. Fußbodenelement nach Anspruch 1,2,3,4,
dadurch gekennzeichnet, daß in der oberen Oberfläche
der Holzspanplatte (1) eine Schicht (8) eines dampf-
bremsenden Mittels eingelassen ist.

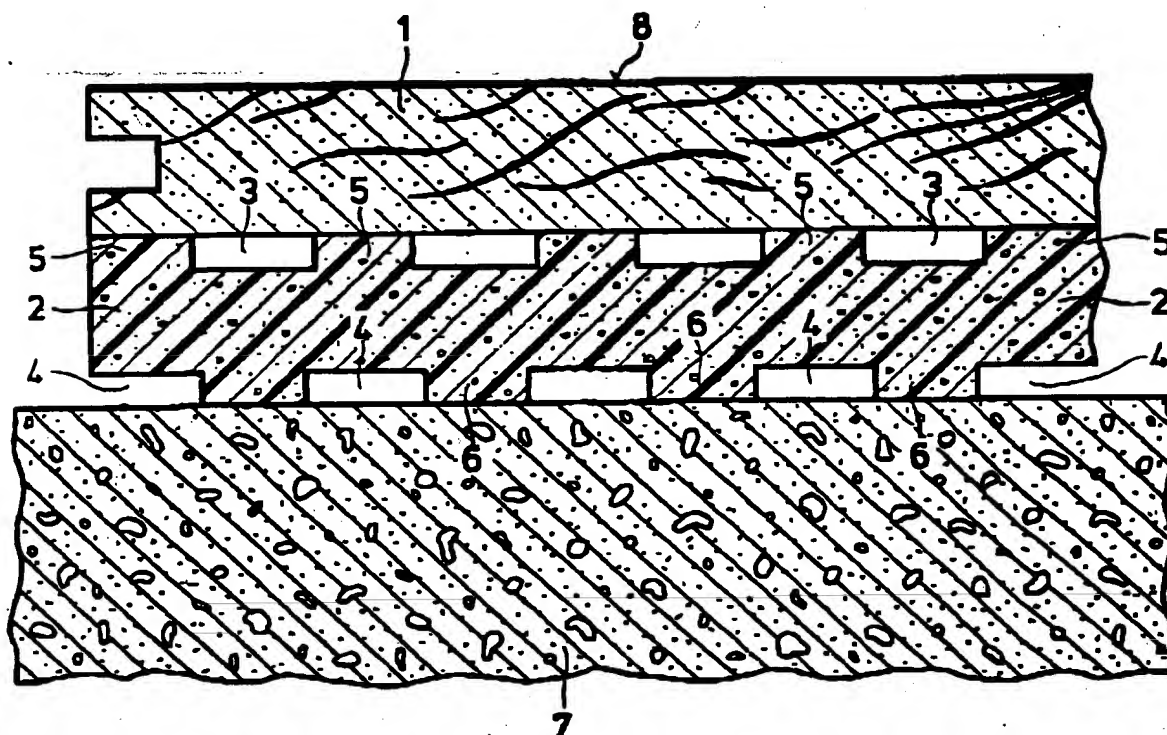
609837/0125

12
Leerseite

NACHGERICHT

2508628

13



EU4P 15-10

AT:27.02.1975 OT:09.09.1976

609837/0125

Received Time

Feb. 8. 3:48PM

Print Time

Feb. 8. 3:54PM